LAGENAUFBAU (Impedanz)

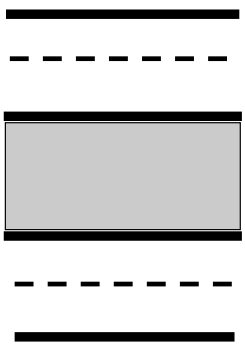
4 - Lagen

Kern: mm Cu / µm

WE-Artikel Nr.:		**4 - Lagen**
KUNDE:	**EMV-Adapter**	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS	S	Folie	18 µm	1)	18	
					1 x 1080 1 x 2116	175	
2	2	P		35 µm		33	
			0,93 mm			930	
3	3	P		35 µm		33	
					1 x 1080 1 x 2116	175	
4	BOT/RS	S	Folie	18 µm	1)	18	



	Imp	Lage	L-Breite	L-Abstand
	Zdiff	Top+BOT=92,30 Ω	254µm	246µm

1) Kupferenddicke Außenlagen nach IPC (35µm Forderung)

Gesamtdicke Material: 1382

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

BASISDICKE:	**1,35**	+/-	0,14	mm		Index	Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,43	+/-	0,15	mm			10.06.2011	M. Schmid
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,47	+/-	0,16	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	
28.09.2006	**M.Kress**	24.10.2006	**S.Baumann**	25.10.2006	**R.Tauras**	00	Seite: 1+